

Express5800/R120h-2E (3rd-Gen) スペック詳細

フレームモデル

2023年06月26日版

製品名称			Express5800/R120h-2E		
モデル名			8x 2.5型ドライブモデル	8x3.5型ドライブモデル	
製品型名			N8100-2844Y	N8100-2845Y	
CPU	Processor		インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(6C/6T, 1.90GHz, 8.25MB, TDP85W), Bronze 3206R(8C/8T, 1.90GHz, 11MB, TDP85W), Silver 4208(8C/16T, 2.10GHz, 11MB, TDP85W), Silver 4210R(10C/20T, 2.40GHz, 13.75MB, TDP100W), Silver 4214R(12C/24T, 2.40GHz, 16.50MB, TDP100W), Silver 4215R(8C/16T, 3.20GHz, 11MB, TDP130W), Gold 5218R(20C/40T, 2.10GHz, 27.5MB, TDP125W), Gold 5222(4C/8T, 3.80GHz, 16.50MB, TDP105W), Gold 6230R(26C/52T, 2.10GHz, 35.75MB, TDP150W), Gold 6244(8C/16T, 3.60GHz, 24.75MB, TDP150W), Gold 6248(20C/40T, 2.50GHz, 27.50MB, TDP150W),Gold 6208U(16C/32T, 2.90GHz, 22MB, TDP150W), Gold 6210U(20C/40T, 2.50GHz, 27.50MB, TDP150W)		
		標準搭載数 / 最大搭載数	0/2		
		コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)		
		インテル® 64	対応		
		インテル® パーチャライゼーション・テクノロジー	対応		
		インテル® ハイバースレディング・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3204は除く)		
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3204は除く)		
		CPUソケット形状	LGA3647		
	ホットプラグ	-			
	冷却方式	ファンなしヒートシンク			
チップセット			インテル® C622 チップセット		
メモリ		搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Registered DIMM : 1TB (16x 64GB)		
		メモリソケット数	16		
		増設単位	1		
		搭載メモリ	DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB)		
		最大動作周波数	2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)		
		メモリバス帯域(チャネルあたり)	23.4GB/s		
		メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)		
		誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, DDDC, ADDDC		
		メモリスベアリング	対応		
		メモリミラーリング	対応		
		ホットプラグ	-		
		モジュールピン数	288 ピン		
		動作電圧	1.2V		
バッファ機能	対応				
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ 8x2.5型増設ドライブ(オプション)	8x3.5型ドライブ
			リア	2x2.5型増設ドライブ(オプション)	
		内部	-		
		内蔵標準	-		
		内蔵最大	2.5型HDD: SATA 52TB (26x 2TB), SAS 62.4TB (26x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 199.68TB (26x 7.68TB), SAS SSD : 83.2TB (26x3.2TB) (オプションHDDケージ追加時)	3.5型HDD : SATA 144TB(8x 18TB), ニアラインSAS 96TB(8x 12TB) + 2.5型HDD: SATA 4TB (2x 2TB), SAS 4.8TB (2x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 15.36TB (2x 7.68TB) (オプションHDDケージ追加時)	
			対応		
	ホットスワップ	対応			
	インタフェース規格とRAID構成		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)		
	光ディスクドライブ		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1		
	FDD		オプション: Flash FDD (1.44MB) *2		
	拡張ベイ		-		
	拡張スロット	対応スロット	標準ライザなし(必須選択) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x LOMカード専用(2x1000BASE-T or 10GBASE-SR or 10GBASE-T) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)		
規格		PCI Express 1.1, 2.0, 3.0			
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB			
	グラフィック表示 と 解像度	640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200			
標準インタフェース	フロント	1x USB3.0(Type A), 1x USB2.0(Type A) (BMC用)			
	リア	2x USB3.0 (TypeA) , 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 2x データLANコネクタ (1000BASE-Tのみ対応 (RJ-45))*7 1x シリアルポート (オプション)			
		内部	1x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 3.0		
ネットワーク	実装形式	オンボード			
	コントローラ	Intel C622 Chipset内蔵			
	チームング	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)			
	FEC / GEC	対応			
	ジャンボフレーム	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)			
リモート	コントローラ	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応			
	マネージメント	BMC			
マネージメント	マネージメント用ポート	Marvell PHY			
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)		対応			
キーボード / マウス		オプション			
BIOS Version (出荷当初)		System ROM U31 v2.32 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)			
BMC Firmware Revision (出荷当初)		2.14(最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)			
System Sleep State		S0, S5			
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)			
冗長ファン		対応 (オプション, ホットプラグ不可)			
筐体デザイン		2Uラックマウント			
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)		445.4mm × 634.7mm × 87.3mm (フロントベゼル/レール/突起物含まず)			
質量 (最小 / 最大)		14kg / 33kg	16kg / 33kg		
電源	選択必須オプション <u>AC電源ユニット(N8181-159, 160)</u> 500W/800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)				
	<u>AC電源ユニット(N8181-161)</u> 800W 80 PLUS® Titanium取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)				
	消費電力(100V最大構成時, 最大電力)				
	消費電力(200V最大構成時, 最大電力)				
発熱量		1167VA / 1161W	985VA / 982W		
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率*9		4389HJ/h	3971KJ/h		
音量	音圧レベル (待機時 / 高負荷時)	12.3 (区分 2)			
		28.5dBA / 39.7dBA			
温度条件		ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床上: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床上: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10～35℃(条件付きで5～40℃/45℃対応可) *6, 保管時: -30～60℃			
湿度条件		動作時: 8～90%, 保管時: 5～95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)			
ハードウェア認証規定		VCCI クラス A			
OS認証		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware			
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル			
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月～金, 9:00～18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)			
インストールOS		3年パーツ保証			
サポートOS	NECサポート	-			
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard 、Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2022 Standard 、Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7.7以降 *3, Red Hat® Enterprise Linux® 8.1以降 *3 VMware ESXi™ 6.5 Update3, VMware ESXi™ 6.7 Update3, VMware ESXi™ 7.0以降, VMware ESXi™ 8.0以降			
動作確認OS *4		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います			

注意事項

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで, ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで, MD2 = 167.6mmまで を示します

注釈

- *1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1台は必ず手配してください。
- *2 必要に応じて手配してください。主な用途については「Flash FDD 製品概要と利用ケース」のシステム構成ガイドをご参照ください。
- *3 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスセットの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。
- *4 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。
- *6 40℃/45℃環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細はシステム構成ガイド「リファレンス」の「40℃/45℃対応についての注意事項」をご参照ください。
- *7 100BASE-xx,10BASE-xは非対応です。
- *9 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。